

2022年3月期 第1四半期 決算補足説明資料

JASDAQ 証券コード:6614

2021年8月



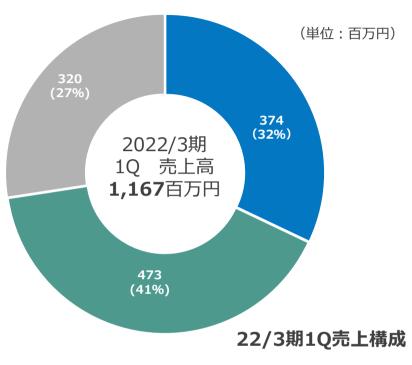
売上高および各利益とも概ね計画以上の進捗

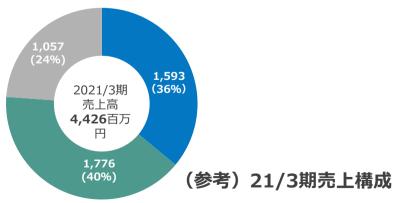
- ●当社の売上・利益は第4四半期に集中する傾向があり、今第1四半期は軟調を予想していたが、予想を上回る進捗となった。
- ●売上高は、新型コロナウイルス、材料納期遅延の影響を受けたが、1Q計画比増収。
- ●経常利益は、高付加価値製品への取り組み、コスト削減の取り組みを行ったことにより、 1Q計画比増益。下期のウェイトが高いため、通期での進捗は18.3%となる。

(単位:百万円、%)

	2022/3期 通期予想		2022/3期 1Q実績		計画比	
	金額	構成比	金額	構成比	進捗率	
売 上 高	5,096	100	1,167	100	22.9	
売上総利益	1,314	25.8	285	24.4	21.7	
販 管 費	1,098	21.5	242	20.7	22.0	
営 業 利 益	215	4.2	43	3.7	20.0	
営業利益率	4.2		3.7		-	
営業外損益	26	0.5	2	0.2	7.7	
経 常 利 益	241	4.7	44	3.8	18.3	
減価償却費合計	124	2.4	22	1.9	17.7	
当期純利益	168	3.3	15	1.3	8.9	







電子システム事業

半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

マイクロエレクトロニクス事業

LSI設計(アナログ・デジタル)、IP開発

電源IC設計、高速I/F回路設計、イメージセンサ回路 設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計 JPEG、MIPI、IPコア

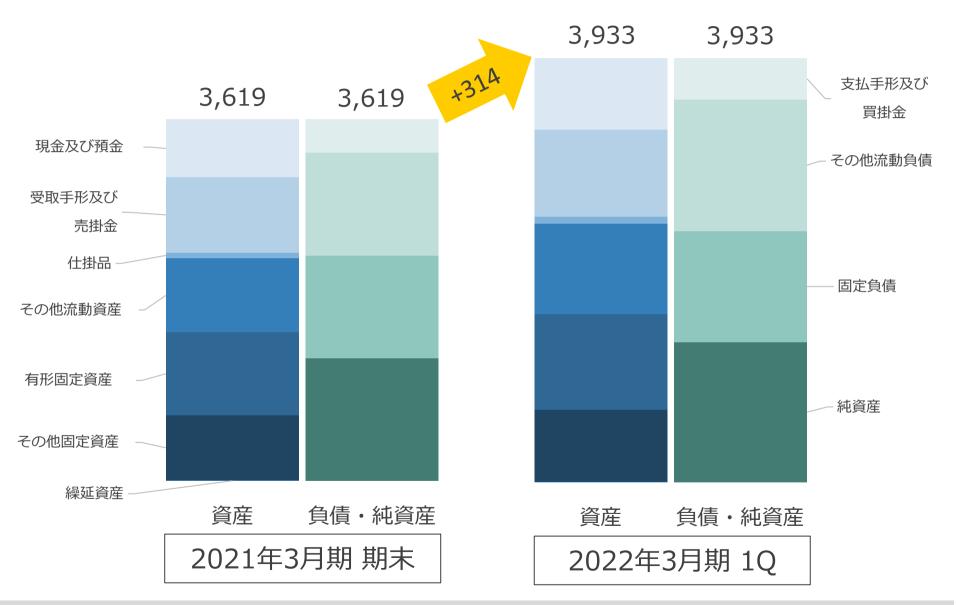
製品開発事業

画像関連機器開発

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、 画像処理システム、画像処理モジュール



(単位:百万円)





2021年 4月 21日 第三者割当増資

5月14日 決算発表

1Q

6月11日 決算説明会

6月28日 第49期 定時株主総会

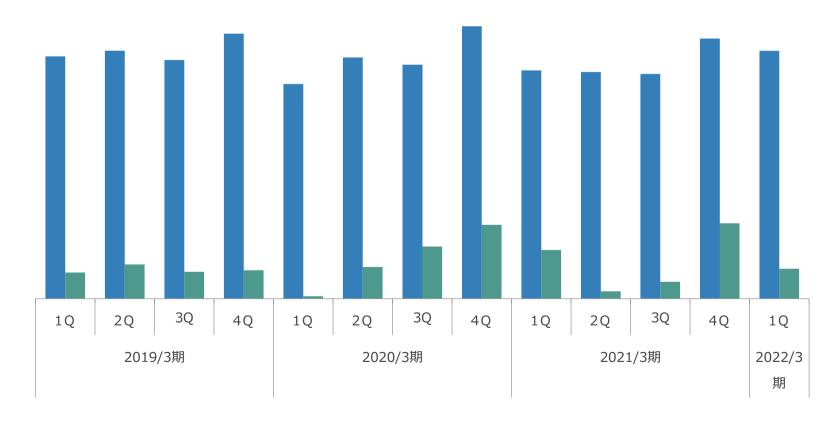
7月 9日 東京証券取引所より 「新市場区分における上場維持基準への 適合状況に関する一次判定結果」の適合通知

を受領



顧客のプロジェクト(製品開発等)サイクル、当年度の量産開始が下期から開始する傾向などにより、売上・利益ともに4Qが最も高くなる傾向

■売上高 ■経常利益



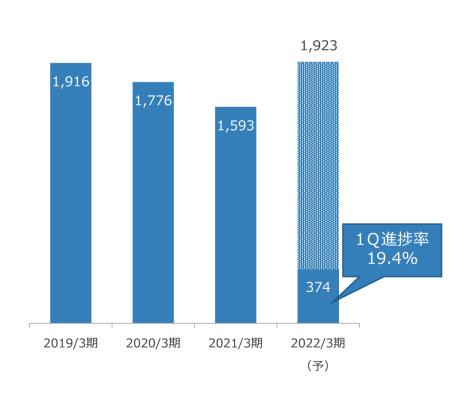
※経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。



半導体周辺機器開発により培われた技術で、半導体検査装置・産業機器を提供 (開発~ものづくりまで対応)

【売上高】

(単位:百万円)



1Qトピックス

IoT-PLC通信モジュール

IEEE1901-2010準拠 機器組込み用モジュール の取り扱いを開始

特徴

- ▶ 既設配線利用のネットワーク構築
- > 長距離・高速通信が可能
- ▶ 暗号と伝送路判定で高セキュリティ
- ▶ 複数のお客様にサンプル出荷、PoC 対応開始

セグメント別説明(マイクロエレクトロニクス事業)

(単位:百万円)



高速I/F、電源技術、画像処理技術をコアにしたモバイル、車載機器分野等での一貫開発 (設計〜評価)に対応

【売上高】

2019/3期

2020/3期

1,839 1,842 1,775 1Q進捗率 24.1%

2021/3期

2022/3期(予)

1Qトピックス

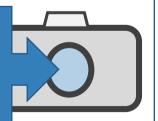
アナログ半導体設計受託
米中摩擦の影響により落ち込んでいたセンシング半導体の開発が復調、回復後の20年Q4を維持
スマートフォン向けセンサ関連
アナログ設計受託
(前期Q4比:102%)

➤ デジタル半導体設計受託 画像処理関連LSIの設計受託が堅調に推移 大型案件を受注

DSC向け画像処理関連

デジタル設計受託

(前年同期比:231%)

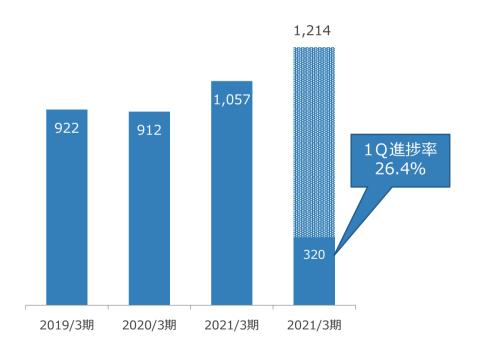




コンビニATM等社会インフラ分野から応用製品(医療・介護関連:ビュー+センシング)への展開組み込みカメラシステム分野での技術力が強み

【売上高】

(単位:百万円)



1Qトピックス

▶ 画像センシング用カメラ新製品2機種リリース

・製品名 : 200万画素USBカメラモジュール ・型 番 : KBCR-S03TUA/KBCR-S03TU

・サンプル:2021年4月

・量産時期:2022年1月



▶ 新製品の特長

- ・当社独自の画像センシング用露光制御技術により 画像処理精度を飛躍的に向上させるカメラ製品です。
- ・同時に独立した2種類の露光制御が可能。
- ・2種類の露光で外乱光による白飛びや黒潰れを解決し センシングしたい領域の最適な露光を実現。
- 画像データを用いた高精度センシングが必要な製品への応用が期待されます。

用途例: 顔認証、人物検出、物体認識、OR/バーコードリーダーなど



①逆光による顔の黒潰れ ②照明による社員証の反射



①逆光下でも顔の認識が可能 ②社員証のコード認識が可能



売上高変更なし、営業利益は30.2%増、経常利益18.7%増、当期純利益19.0%増を予想 第1四半期の利益増額分を反映し、利益面での修正を行う。

- ●営業利益は第1四半期の利益増額分を反映
- ●経常利益は利益増額分を反映するが、下期以降の部材調達ロスなどを総合的に判断し、相当額を減額

(単位:百万円、%)

科目		2022/3期 当初計画		2022/3期 修正予想		当初計画比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減	増減率
売上	高	5,096	100	5,096	100	0	0.0
営業	利益	215	4.2	280	5.5	65	30.2
経常	利益	241	4.7	286	5.6	45	18.7
当期純	利益	168	3.3	200	3.9	32	19.0

今期計画に対する進捗【人員】



半導体事業における増産に対応するため、人員増強を図ります。

通期で28人の計画に対し、1Qにて17人増員しました。





計画に対し、若干遅れて進捗しております。

(1Qの進捗率計画24.5%に対して)

。 1Q 49 17.4%

研究開発費

通期計画:282



顧客の未解決課題の解決、顧客ニーズの充足の視点で、 競合他社に対して優位性のある技術・製品の開発に取り組む

研究開発分野

半導体検査装置、計測システム、 IPコア、高速IF回路、 画像処理システム、カメラの性能向上、 新機能開発

電子システム事業

・半導体検査装置・個別温調装置・HD-PLC

マイクロエレクトロニクス事業

・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

製品開発事業

・エッジAI・高画素インテリジェントカメラ・介護向けシステム



本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものでありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

【お問い合わせ先】

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail: IR-contact@shikino.co.jp

TEL: 0765-22-3477 FAX: 0765-22-3916

ホームページ: https://www.shikino.co.jp/